

PCT/JP 03/08773

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

10.07.03

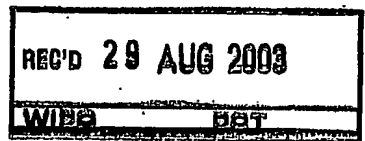
別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2002年 8月 5日
Date of Application:

出願番号 特願2002-227840
Application Number:
[ST. 10/C]: [JP 2002-227840]

出願人 セイコーエプソン株式会社
Applicant(s):

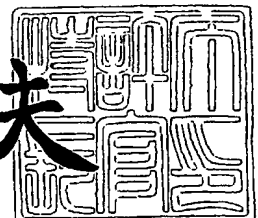


PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2003年 8月15日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 J0091851

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 B41J 2/045

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

【氏名】 八十島 健

【特許出願人】

【識別番号】 000002369

【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社

【代理人】

【識別番号】 100101236

【弁理士】

【氏名又は名称】 栗原 浩之

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 042309

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9806571

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 液体噴射ヘッド及びその製造方法並びに液体噴射装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 シリコン単結晶基板からなりノズル開口に連通する圧力発生室が形成される流路形成基板と、該流路形成基板の一方面側に振動板を介して設けられて前記圧力発生室内に圧力変化を生じさせる圧電素子とを具備する液体噴射ヘッドにおいて、

少なくとも前記圧力発生室の内壁表面に酸化タンタルからなる耐液体性の保護膜が設けられていることを特徴とする液体噴射ヘッド。

【請求項2】 請求項1において、前記保護膜のpH8.5以上の液体によるエッチングレートが0.05nm/day以下であることを特徴とする液体噴射ヘッド。

【請求項3】 請求項1又は2において、前記保護膜がイオンアシスト蒸着によって形成されていることを特徴とする液体噴射ヘッド。

【請求項4】 請求項1～3の何れかにおいて、前記流路形成基板には、前記圧力発生室内へ液体を供給するための液体流路が設けられており、当該液体流路の内壁表面にも前記保護膜が設けられていることを特徴とする液体噴射ヘッド。

【請求項5】 請求項1～4の何れかにおいて、前記圧力発生室がシリコン単結晶基板に異方性エッチングにより形成され、前記圧電素子の各層が成膜及びリソグラフィ法により形成されたものであることを特徴とする液体噴射ヘッド。

【請求項6】 請求項1～5の何れかの液体噴射ヘッドを具備することを特徴とする液体噴射装置。

【請求項7】 シリコン単結晶基板からなりノズル開口に連通する圧力発生室が形成される流路形成基板と、該流路形成基板の一方面側に振動板を介して設けられて前記圧力発生室内に圧力変化を生じさせる圧電素子とを具備する液体噴射ヘッドの製造方法において、

少なくとも前記圧力発生室の内壁表面に100℃以下の温度条件で金属材料からなる耐液体性の保護膜を形成する工程を有することを特徴とする液体噴射ヘッ

ドの製造方法。

【請求項 8】 請求項 7 において、前記保護膜がイオンアシスト蒸着によって形成されていることを特徴とする液体噴射ヘッドの製造方法。

【請求項 9】 請求項 7 又は 8 において、前記金属材料が、酸化タンタル又は酸化ジルコニウムであることを特徴とする液体噴射ヘッドの製造方法。

【請求項 10】 請求項 7～9 の何れかにおいて、前記流路形成基板に前記圧力発生室内へ液体を供給するための液体流路を形成した後に、当該液体流路の内壁表面にも前記保護膜を形成することを特徴とする液体噴射ヘッドの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、液滴を噴射するノズル開口と連通する圧力発生室に供給された液体を圧電素子の変形により加圧することによって、ノズル開口から液滴を噴射させる液体噴射ヘッド及びその製造方法並びに液体噴射装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

液体噴射装置としては、例えば、圧電素子や発熱素子によりインク滴吐出のための圧力を発生させる複数の圧力発生室と、各圧力発生室にインクを供給する共通のリザーバと、各圧力発生室に連通するノズル開口とを備えたインクジェット式記録ヘッドを具備するインクジェット式記録装置があり、このインクジェット式記録装置では、印字信号に対応するノズルと連通した圧力発生室内のインクに吐出エネルギーを印加してノズル開口からインク滴を吐出させる。

【0003】

このようなインクジェット式記録ヘッドには、前述したように圧力発生室として圧力発生室内に駆動信号によりジュール熱を発生する抵抗線等の発熱素子を設け、この発熱素子の発生するバブルによってノズル開口からインク滴を吐出させるものと、圧力発生室の一部を振動板で構成し、この振動板を圧電素子により変形させてノズル開口からインク滴を吐出させる圧電振動式の 2 種類のものに大別

される。

【0004】

また、圧電振動式のインクジェット式記録ヘッドには、圧電素子の軸方向に伸長、収縮する縦振動モードの圧電アクチュエータを使用したものと、たわみ振動モードの圧電アクチュエータを使用したものの2種類が実用化されている。

【0005】

前者は圧電素子の端面を振動板に当接させることにより圧力発生室の容積を変化させることができ、高密度印刷に適したヘッドの製作が可能である反面、圧電素子をノズル開口の配列ピッチに一致させて櫛歯状に切り分けるという困難な工程や、切り分けられた圧電素子を圧力発生室に位置決めして固定する作業が必要となり、製造工程が複雑であるという問題がある。

【0006】

これに対して後者は、圧電材料のグリーンシートを圧力発生室の形状に合わせて貼付し、これを焼成するという比較的簡単な工程で振動板に圧電素子を作り付けることができるものの、たわみ振動を利用する関係上、ある程度の面積が必要となり、高密度配列が困難であるという問題がある。

【0007】

一方、後者の記録ヘッドの不都合を解消すべく、特開平5-286131号公報に見られるように、振動板の表面全体に亘って成膜技術により均一な圧電材料層を形成し、この圧電材料層をリソグラフィ法により圧力発生室に対応する形状に切り分けて各圧力発生室毎に独立するように圧電素子を形成したものが提案されている。

【0008】

これによれば圧電素子を振動板に貼付ける作業が不要となって、リソグラフィ法という精密で、かつ簡便な手法で圧電素子を高密度に作り付けることができるばかりでなく、圧電素子の厚みを薄くできて高速駆動が可能になるという利点がある。

【0009】

また、一般的に、圧力発生室が形成される流路形成基板の圧電素子側の一方面

には、この圧電素子を封止する圧電素子保持部を有する封止基板が接合されており、これにより、圧電素子の外部環境に起因する破壊が防止されている。

【0010】

【発明が解決しようとする課題】

このような従来のインクジェット式記録ヘッドは、インクに接触する構成部位が耐インク性について考慮されていないのが実状である。

【0011】

例えば、流路形成基板を形成する材料にシリコン単結晶基板（Si）が用いられている場合には、アルカリ性のインクを用いると、インクによって流路形成基板が徐々に溶解されて各圧力発生室の幅が大きくなってしまう。

【0012】

また、振動板を形成する材料に酸化シリコン（SiO₂）が用いられている場合には、流路形成基板と同様に、インクによって振動板が徐々に溶解されて振動板の厚さが薄くなってしまう。

【0013】

そして、これらのことがインク吐出時の圧力発生室及び振動板の変位量を変化させる原因となって、インク吐出特性が徐々に低下してしまう問題が発生している。

【0014】

また、流路形成基板には、圧力発生室内へインクを供給するインク供給路が形成されているが、インクによって流路形成基板が徐々に溶解されるとインク供給路の形状が安定せず、これが各圧力発生室へのインクの供給不良を招く原因となり、インク吐出特性が更に低下してしまうという問題もある。

【0015】

さらに、このようにインクに溶解された流路形成基板の溶解物は、例えば、温度変化等に伴ってインク中に析出する析出物（Si）となる場合がある。このような析出物は、インクと共に各圧力発生室内へ運ばれて各ノズル開口で詰まってしまうため、いわゆるノズル詰まりが発生するという問題もある。

【0016】

なお、比較的大きな pH のインクを用いた場合には、流路形成基板及び振動板が溶解される速度が実質的に高まってしまうため、インク吐出特性を著しく低下してしまう。また、インク吐出特性の低下が著しい場合には、インク滴が吐出されなくなり、重大な問題となる。

【0017】

なお、このような問題は、インクを吐出するインクジェット式記録ヘッドだけでなく、勿論、インク以外のアルカリ性の液体を噴射する他の液体噴射ヘッドにおいても、同様に存在する。

【0018】

本発明は、このような事情に鑑み、液体吐出特性を長期間一定に維持することができ且つノズル詰まりを防止した液体噴射ヘッド及びその製造方法並びに液体噴射装置を提供することを課題とする。

【0019】

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決する本発明の第1の態様は、シリコン単結晶基板からなりノズル開口に連通する圧力発生室が形成される流路形成基板と、該流路形成基板の一方側面に振動板を介して設けられて前記圧力発生室内に圧力変化を生じさせる圧電素子とを具備する液体噴射ヘッドにおいて、少なくとも前記圧力発生室の内壁表面に酸化タンタルからなる耐液体性の保護膜が設けられていることを特徴とする液体噴射ヘッドにある。

【0020】

かかる第1の態様では、液体に対して非常に優れた耐エッチング性を有する保護膜を形成でき、流路形成基板が液体に溶解されるのを確実に防止することができる。したがって、各圧力発生室を製品製造時と略同一形状に維持することができる。また、ノズル詰まりを防止することもできる。

【0021】

本発明の第2の態様は、第1の態様において、前記保護膜の pH 8.5 以上の液体によるエッチングレートが 0.05 nm/day 以下であることを特徴とす

る液体噴射ヘッドにある。

【0022】

かかる第2の態様では、保護膜がpH8.5以上の比較的大きなpHの液体、すなわち、アルカリ性の液体に対して優れた耐エッチング性を有しているため、各圧力発生室を製品製造時と略同一形状に更に長期間維持することができる。

【0023】

本発明の第3の態様は、第1又は2の態様において、前記保護膜がイオンアシスト蒸着によって形成されていることを特徴とする液体噴射ヘッドにある。

【0024】

かかる第3の態様では、緻密な保護膜を比較的容易且つ確実に形成することができる。

【0025】

本発明の第4の態様は、第1～3の何れかの態様において、前記流路形成基板には、前記圧力発生室内へ液体を供給するための液体流路が設けられており、当該液体流路の内壁表面にも前記保護膜が設けられていることを特徴とする液体噴射ヘッドにある。

【0026】

かかる第4の態様では、液体流路の内壁表面が液体に溶解されるのを保護膜によって確実に防止できるため、液体流路の形状を製品製造時と略同一形状に維持することができる。したがって、各圧力発生室に液体を良好に供給することができる。

【0027】

本発明の第5の態様は、第1～4の何れかの態様において、前記圧力発生室がシリコン単結晶基板に異方性エッチングにより形成され、前記圧電素子の各層が成膜及びリソグラフィ法により形成されたものであることを特徴とする液体噴射ヘッドにある。

【0028】

かかる第5の態様では、高密度のノズル開口を有する液体噴射ヘッドを大量に且つ比較的容易に製造することができる。

【0029】

本発明の第6の態様は、第1～5の何れかの態様の液体噴射ヘッドを具備することを特徴とする液体噴射装置にある。

【0030】

かかる第6の態様では、液体吐出特性が実質的に安定し且つ信頼性を向上した液体噴射装置を実現することができる。

【0031】

本発明の第7の態様は、シリコン単結晶基板からなりノズル開口に連通する圧力発生室が形成される流路形成基板と、該流路形成基板の一方面側に振動板を介して設けられて前記圧力発生室内に圧力変化を生じさせる圧電素子とを具備する液体噴射ヘッドの製造方法において、少なくとも前記圧力発生室の内壁表面に100℃以下の温度条件で金属材料からなる耐液体性の保護膜を形成する工程を有することを特徴とする液体噴射ヘッドの製造方法にある。

【0032】

かかる第7の態様では、比較的低い温度条件、例えば、100℃以下で保護膜を形成することができるため、例えば、圧電素子等が破壊されるのを確実に防止することができる。

【0033】

本発明の第8の態様は、第7の態様において、前記保護膜がイオンアシスト蒸着によって形成されていることを特徴とする液体噴射ヘッドの製造方法にある。

【0034】

かかる第8の態様では、比較的低い温度条件下で保護膜を形成することができる。

【0035】

本発明の第9の態様は、第7又は8の態様において、前記金属材料が、酸化タantal又は酸化ジルコニウムであることを特徴とする液体噴射ヘッドの製造方法にある。

【0036】

かかる第9の態様では、比較的低い温度条件下での膜形成が可能であり且つ液

体に対して非常に優れた耐エッチング性を有する保護膜を形成できる。特に、酸化タンタルによって形成された保護膜は、比較的大きな pH、例えば、pH 8.5 以上の液体に対して特に優れた耐エッチング性を発揮する。これにより、各圧力発生室を製品製造時と略同一形状に長期間維持することができる。

【0037】

本発明の第10の態様は、第7～9の何れかの態様において、前記流路形成基板に前記圧力発生室内へ液体を供給するための液体流路を形成した後に、当該液体流路の内壁表面にも前記保護膜を形成することを特徴とする液体噴射ヘッドの製造方法にある。

【0038】

かかる第10の態様では、液体流路の内壁表面が液体に溶解されるのを保護膜によって確実に防止できるため、液体流路の形状を製品製造時と略同一形状に維持することができる。したがって、各圧力発生室に液体を良好に供給することができる。

【0039】

【発明の実施の形態】

以下に本発明を実施形態に基づいて詳細に説明する。

【0040】

（実施形態1）

図1は、本発明の実施形態1に係るインクジェット式記録ヘッドの概略を示す分解斜視図であり、図2は、図1の平面図及び断面図である。

【0041】

図示するように、流路形成基板10は、本実施形態では面方位（110）のシリコン単結晶基板からなり、その一方面には予め熱酸化により形成した二酸化シリコンからなる、厚さ1～2 μmの弾性膜50が形成されている。

【0042】

この流路形成基板10には、シリコン単結晶基板をその一方面側から異方性エッチングすることにより、複数の隔壁11によって区画された圧力発生室12が幅方向に並設されている。また、その長手方向外側には、後述する封止基板30

のリザーバ部 31 と連通される連通部 13 が形成されている。また、この連通部 13 は、各圧力発生室 12 の長手方向一端部でそれぞれインク供給路 14 を介して連通されている。

【0043】

ここで、異方性エッチングは、シリコン単結晶基板のエッチングレートの違いを利用して行われる。例えば、本実施形態では、シリコン単結晶基板を KOH 等のアルカリ溶液に浸漬すると、徐々に侵食されて (110) 面に垂直な第 1 の (111) 面と、この第 1 の (111) 面と約 70 度の角度をなし且つ上記 (110) 面と約 35 度の角度をなす第 2 の (111) 面とが出現し、(110) 面のエッチングレートと比較して (111) 面のエッチングレートが約 1/180 であるという性質を利用して行われる。かかる異方性エッチングにより、二つの第 1 の (111) 面と斜めの二つの第 2 の (111) 面とで形成される平行四辺形状の深さ加工を基本として精密加工を行うことができ、圧力発生室 12 を高密度に配列することができる。

【0044】

本実施形態では、各圧力発生室 12 の長辺を第 1 の (111) 面で、短辺を第 2 の (111) 面で形成している。この圧力発生室 12 は、流路形成基板 10 をほぼ貫通して弾性膜 50 に達するまでエッチングすることにより形成されている。ここで、弾性膜 50 は、シリコン単結晶基板をエッチングするアルカリ溶液に侵される量がきわめて小さい。

【0045】

また、各圧力発生室 12 の一端に連通する各インク供給路 14 は、圧力発生室 12 より浅く形成されており、圧力発生室 12 に流入するインクの流路抵抗を一定に保持している。すなわち、インク供給路 14 は、シリコン単結晶基板を厚さ方向に途中までエッチング（ハーフエッチング）することにより形成されている。なお、ハーフエッチングは、エッチング時間の調整により行われる。

【0046】

このような圧力発生室 12 等が形成される流路形成基板 10 の厚さは、圧力発生室 12 を配設する密度に合わせて最適な厚さを選択することが好ましい。例え

ば、1インチ当たり180個（180 d p i）程度に圧力発生室12を配置する場合には、流路形成基板10の厚さは、180～280 μ m程度、より望ましくは、220 μ m程度とするのが好適である。また、例えば、360 d p i程度と比較的高密度に圧力発生室12を配置する場合には、流路形成基板10の厚さは、100 μ m以下とするのが好ましい。これは、隣接する圧力発生室12間の隔壁11の剛性を保ちつつ、配列密度を高くできるからである。

【0047】

また、流路形成基板10の開口面側には、各圧力発生室12のインク供給路14とは反対側で連通するノズル開口21が穿設されたノズルプレート20が接着剤や熱溶着フィルム等を介して固着されている。なお、このノズルプレート20は、本実施形態では、ステンレス鋼（SUS）で形成されている。

【0048】

ここで、流路形成基板10の少なくとも圧力発生室12の内壁表面には、五酸化タンタル（ Ta_2O_5 ）等の酸化タンタルからなり耐インク性を有する保護膜100が設けられている。この保護膜100を形成する材料としては、本実施形態では、五酸化タンタルを用いた。ここで、耐インク性とは、アルカリ性のインクに対する耐エッチング性のことである。

【0049】

例えば、本実施形態では、圧力発生室12の隔壁11及び弾性膜50の表面に保護膜100を設けるようにし、各圧力発生室12に連通するインク供給路14及び連通部13のインク流路の内壁表面にも保護膜100を設けるようにした。すなわち、流路形成基板10のインクに接触する全ての表面に保護膜100が設けられている。

【0050】

なお、本実施形態では、流路形成基板10の圧力発生室12等が開口する側の表面、すなわち、ノズルプレート20が接合される接合面にも保護膜100が設けられている。勿論、このような領域には、インクが実質的に接触しないため、保護膜100を設けなくてもよい。

【0051】

このような五酸化タンタルからなる保護膜100は、インクに対して非常に優れた耐エッチング性を有し、具体的には、 $\text{pH} 8.5$ 以上のインクによるエッチングレートが 25°C 、 0.05 nm/day 以下である。このように、五酸化タンタルからなる保護膜100は、比較的アルカリ性が強いインクに対して非常に優れた耐エッチング性を有しているため、インクジェット式記録ヘッド用のインクに対しては特に有効である。例えば、本実施形態の保護膜100は、 $\text{pH} 9.1$ のインクによるエッチングレートが 25°C で、 0.03 nm/day であった。

【0052】

このような保護膜100の厚さは、特に限定されないが、本実施形態では、各圧力発生室12及び振動板の変位量を考慮して 50 nm 程度とした。

【0053】

なお、このような保護膜100の材料としては、使用するインクの pH 値によっては、例えば、酸化ジルコニウム (ZrO_2)、ニッケル (Ni) 及びクロム (Cr) 等を用いることもできるが、五酸化タンタルを用いることにより、極めて耐エッチング性に優れた保護膜100が得られる。

【0054】

また、このような保護膜100の形成方法としては、比較的低い温度、本実施形態では、 100°C 以下の条件下で緻密な膜を確実に形成できる成膜方法であれば特に限定されるものではないが、例えば、イオンアシスト蒸着、電子サイクロトロン共鳴スパッタ及び水平対向スパッタ等の物理的气相成長法 (PVD) を挙げることができる。本実施形態では、イオンアシスト蒸着を用いた。なお、このような成膜方法を用いることで、詳しくは後述するが、圧電素子等が破壊されるのを防止することができる。

【0055】

上述したように、本実施形態では、流路形成基板10の圧力発生室12等が開口する側の表面に五酸化タンタルからなる保護膜100を設けるようにしたので、比較的大きな pH のインクに対して非常に優れた耐エッチング性を発揮し、インク吐出特性を長期間一定に維持することができる。

【 0 0 5 6 】

具体的には、圧力発生室 1 2 の内壁表面に保護膜 1 0 0 を設けるようにしたので、流路形成基板 1 0 及び振動板がインクに溶解されることを防止することができる。これにより、圧力発生室 1 2 の形状が実質的に安定、すなわち、製品製造時と略同一形状に維持することができる。また、各圧力発生室 1 2 の内壁表面以外のインク供給路 1 4 及び連通部 1 3 のインク流路の内壁表面にも保護膜 1 0 0 を設けるようにしたので、圧力発生室 1 2 と同様の理由からインク流路の形状を製品製造時と略同一形状に維持することができる。これらのことから、インク吐出特性を長期間一定に維持することができる。

【 0 0 5 7 】

なお、流路形成基板 1 0 がインクに溶解されるのを保護膜 1 0 0 によって防止することができるため、インクに溶解された流路形成基板 1 0 の溶解物がインク中に析出する量が実質的に低減され、ノズル詰まりの発生を防止することができる。これにより、ノズル開口 2 1 からインク滴を良好に吐出させることができる。

【 0 0 5 8 】

一方、このような流路形成基板 1 0 の開口面とは反対側の弾性膜 5 0 の上には、厚さが例えば、約 $0.2 \mu\text{m}$ の下電極膜 6 0 と、厚さが例えば、約 $1 \mu\text{m}$ の圧電体層 7 0 と、厚さが例えば、約 $0.1 \mu\text{m}$ の上電極膜 8 0 とが、後述するプロセスで積層形成されて、圧電素子 3 0 0 を構成している。ここで、圧電素子 3 0 0 は、下電極膜 6 0、圧電体層 7 0、及び上電極膜 8 0 を含む部分をいう。一般的には、圧電素子 3 0 0 の何れか一方の電極を共通電極とし、他方の電極及び圧電体層 7 0 を各圧力発生室 1 2 毎にパターンニングして構成する。そして、ここではパターンニングされた何れか一方の電極及び圧電体層 7 0 から構成され、両電極への電圧の印加により圧電歪みが生じる部分を圧電体能動部という。本実施形態では、下電極膜 6 0 は圧電素子 3 0 0 の共通電極とし、上電極膜 8 0 を圧電素子 3 0 0 の個別電極としているが、駆動回路や配線の都合でこれを逆にしても支障はない。何れの場合においても、各圧力発生室毎に圧電体能動部が形成されることになる。また、ここでは、圧電素子 3 0 0 と当該圧電素子 3 0 0 の駆動に

より変位が生じる振動板とを合わせて圧電アクチュエータと称する。

【0059】

また、このような各圧電素子300の上電極膜80には、例えば、金(Au)等からなるリード電極90がそれぞれ接続されている。このリード電極90は、各圧電素子300の長手方向端部近傍から引き出され、インク供給路14に対応する領域の弾性膜50上までそれぞれ延設されている。

【0060】

この流路形成基板10の圧電素子300側には、圧電素子300の運動を阻害しない程度の空間を確保した状態で、その空間を密封可能な圧電素子保持部32を有する封止基板30が接合され、圧電素子300はこの圧電素子保持部32内に密封されている。

【0061】

さらに、封止基板30には、各圧力発生室12の共通のインク室となるリザーバ110の少なくとも一部を構成するリザーバ部31が設けられ、このリザーバ部31は、上述のように流路形成基板10の連通部13と連通されて各圧力発生室12の共通のインク室となるリザーバ110を構成している。

【0062】

この封止基板30としては、流路形成基板10の熱膨張率と略同一の材料、例えば、ガラス、セラミック材料等を用いることが好ましく、本実施形態では、流路形成基板10と同一材料のシリコン単結晶基板を用いて形成した。

【0063】

また、封止基板30の圧電素子300に対向する領域には、圧電素子300の運動を阻害しない程度の空間を確保した状態で、その空間を密封可能な圧電素子保持部32が設けられ、圧電素子300はこの圧電素子保持部32内に密封されている。

【0064】

なお、封止基板30のリザーバ部31と圧電素子保持部32との間、すなわちインク供給路14に対応する領域には、この封止基板30を厚さ方向に貫通する貫通孔33が設けられている。そして、各圧電素子300から引き出されたリー

ド電極 9 0 は、この貫通孔 3 3 まで延設されており、ワイヤボンディング等により図示しない駆動 I C と接続される。

【 0 0 6 5 】

また、このような封止基板 3 0 上には、封止膜 4 1 及び固定板 4 2 からなるコンプライアンス基板 4 0 が接合されている。封止膜 4 1 は、剛性が低く可撓性を有する材料（例えば、厚さが $6 \mu\text{m}$ のポリフェニレンサルファイド（PPS）フィルム）からなり、この封止膜 4 1 によってリザーバ部 3 1 の一方向が封止されている。また、固定板 4 2 は、金属等の硬質の材料（例えば、厚さが $30 \mu\text{m}$ のステンレス鋼（SUS）等）で形成される。この固定板 4 2 のリザーバ 1 1 0 に対向する領域は、厚さ方向に完全に除去された開口部 4 3 となっているため、リザーバ 1 1 0 の一方向は可撓性を有する封止膜 4 1 のみで封止されている。

【 0 0 6 6 】

このような本実施形態のインクジェット式記録ヘッドは、図示しない外部インク供給手段からインクを取り込み、リザーバ 1 1 0 からノズル開口 2 1 に至るまで内部をインクで満たした後、図示しない駆動回路からの記録信号に従い、外部配線を介して圧力発生室 1 2 に対応するそれぞれの下電極膜 6 0 と上電極膜 8 0 との間に電圧を印加し、弾性膜 5 0、下電極膜 6 0 及び圧電体層 7 0 をたわみ変形させることにより、各圧力発生室 1 2 内の圧力が高まりノズル開口 2 1 からインク滴が吐出する。

【 0 0 6 7 】

以下、このような本実施形態のインクジェット式記録ヘッドの製造方法、特に、流路形成基板 1 0 上に圧電素子 3 0 0 を形成するプロセス及び流路形成基板 1 0 に圧力発生室 1 2 等を形成するプロセスについて、図 3 ～図 5 を参照して説明する。なお、図 3 ～図 5 は、圧力発生室 1 2 の長手方向の断面図である。

【 0 0 6 8 】

まず、図 3（a）に示すように、流路形成基板 1 0 となるシリコン単結晶基板のウェハを約 1100°C の拡散炉で熱酸化して弾性膜 5 0 を構成する二酸化シリコン膜 5 1 を全面に形成する。この二酸化シリコン膜 5 1 は、詳しくは後述するが、弾性膜 5 0 を構成すると共にシリコン単結晶基板をエッチングする際のマス

クとして用いられるものである。

【0069】

次いで、図3（b）に示すように、弾性膜50となる二酸化シリコン膜51上にスパッタリングで下電極膜60を形成すると共に、所定形状にパターニングする。このような下電極膜60の材料としては、白金（Pt）等が好適である。これは、スパッタリング法やゾルーゲル法で成膜する後述の圧電体層70は、成膜後に大気雰囲気下又は酸素雰囲気下で600～1000℃程度の温度で焼成して結晶化させる必要があるからである。すなわち、下電極膜60の材料は、このような高温、酸化雰囲気下で導電性を保持できなければならず、殊に、圧電体層70としてチタン酸ジルコン酸鉛（PZT）を用いた場合には、酸化鉛の拡散による導電性の変化が少ないことが望ましく、これらの理由から白金が好適である。

【0070】

次に、図3（c）に示すように、圧電体層70を成膜する。この圧電体層70は、結晶が配向していることが好ましい。例えば、本実施形態では、金属有機物を触媒に溶解・分散したいわゆるゾルを塗布乾燥してゲル化し、さらに高温で焼成することで金属酸化物からなる圧電体層70を得る、いわゆるゾルーゲル法を用いて形成することにより、結晶が配向している圧電体層70とした。圧電体層70の材料としては、チタン酸ジルコン酸鉛系の材料がインクジェット式記録ヘッドに使用する場合には好適である。なお、この圧電体層70の成膜方法は、特に限定されず、例えば、スパッタリング法で形成してもよい。

【0071】

さらに、ゾルーゲル法又はスパッタリング法等によりチタン酸ジルコン酸鉛の前駆体膜を形成後、アルカリ水溶液中での高圧処理法にて低温で結晶成長させる方法を用いてもよい。

【0072】

何れにしても、このように成膜された圧電体層70は、バルクの圧電体とは異なり結晶が優先配向しており、且つ本実施形態では、圧電体層70は、結晶が柱状に形成されている。なお、優先配向とは、結晶の配向方向が無秩序ではなく、特定の結晶面がほぼ一定の方向に向いている状態をいう。また、結晶が柱状の薄

膜とは、略円柱体の結晶が中心軸を厚さ方向に略一致させた状態で面方向に亘って集合して薄膜を形成している状態をいう。勿論、優先配向した粒状の結晶で形成された薄膜であってもよい。なお、このように薄膜工程で製造された圧電体層の厚さは、一般的に0.2～5 μm である。

【0073】

次に、図3(d)に示すように、上電極膜80を成膜する。上電極膜80は、導電性の高い材料であればよく、アルミニウム、金、ニッケル、白金等の多くの金属や、導電性酸化物等を使用できる。本実施形態では、白金をスパッタリングにより成膜している。

【0074】

次に、図3(e)に示すように、圧電体層70及び上電極膜80のみをエッチングして圧電素子300のパターニングを行う。

【0075】

次に、図4(a)に示すように、リード電極90を形成する。具体的には、例えば、金(Au)等からなるリード電極90を流路形成基板10の全面に亘って形成すると共に、各圧電素子300毎にパターニングする。

【0076】

以上が膜形成プロセスである。このようにして膜形成を行った後、前述したアルカリ溶液によるシリコン単結晶基板（流路形成基板10）の異方性エッチングを行い、圧力発生室12、連通部13及びインク供給路14を形成する。

【0077】

具体的には、まず、図4(b)に示すように、流路形成基板10の圧電素子300側に、リザーバ部31、圧電素子保持部32及び接続孔33等を有する封止基板30を接合する。これにより、圧電素子300を圧電素子保持部32内に密封する。

【0078】

次に、図4(c)に示すように、流路形成基板10の表面上に形成されている二酸化シリコン膜51を所定形状にパターニングすることによりマスクパターン52を形成する。

【 0 0 7 9 】

次いで、図 5 (a) に示すように、このマスクパターン 5 2 を介して、前述したアルカリ溶液による異方性エッチングを行うことにより、流路形成基板 1 0 に圧力発生室 1 2 、連通部 1 3 及びインク供給路 1 4 等を形成する。なお、このように異方性エッチングを行う際には、封止基板 3 0 の表面を封止した状態で行う。

【 0 0 8 0 】

その後、図 5 (b) に示すように、シリコン単結晶基板の圧力発生室 1 2 、連通部 1 3 及びインク供給路 1 4 の内壁表面上に、1 0 0 ℃以下の温度条件下で、例えば、本実施形態では、イオンアシスト蒸着によって五酸化タンタル (Ta_2O_5) からなる耐インク性の保護膜 1 0 0 を形成する。なお、このとき、流路形成基板 1 0 の各圧力発生室 1 2 等が開口する側の面、すなわち、二酸化シリコン膜 5 1 の表面にも保護膜 1 0 0 が形成される。

【 0 0 8 1 】

このように、本実施形態では、イオンアシスト蒸着を用いるようにしたので、1 0 0 ℃以下の温度条件下で保護膜 1 0 0 を比較的容易且つ確実に形成することができる。また、1 0 0 ℃以下の温度条件では、圧電素子保持部 3 2 等の密封された空間が破壊される心配もない。もちろん、圧電素子 3 0 0 へ影響を及ぼすこともない。

【 0 0 8 2 】

また、五酸化タンタルを用いて保護膜 1 0 0 を形成することにより、非常に優れた耐エッチング性を有する保護膜 1 0 0 とすることができ、流路形成基板 1 0 がインクに溶解されるのを確実に防止することができる。したがって、インク吐出特性を長期間一定に維持することができる。

【 0 0 8 3 】

なお、このようにして保護膜 1 0 0 を形成した後は、流路形成基板 1 0 の封止基板 3 0 とは反対側の面にノズル開口 2 1 が穿設されたノズルプレート 2 0 を接合すると共に、封止基板 3 0 にコンプライアンス基板 4 0 を接合し、図 1 に示すような本実施形態のインクジェット式記録ヘッドとする。

【 0 0 8 4 】

(他の実施形態)

以上、本発明の各実施形態を説明したが、インクジェット式記録ヘッド及びその製造方法の基本的構成は上述したものに限定されるものではない。

【 0 0 8 5 】

例えば、上述した実施形態では、各圧力発生室 1 2、連通部 1 3 及びインク供給路 1 4 の内壁表面に耐インク性の保護膜 1 0 0 を設けるようにしたが、これに限定されず、少なくとも各圧力発生室の内壁表面に保護膜を設ければよい。このような構成としても、インク吐出特性を長期間一定に維持することができる。

【 0 0 8 6 】

また、上述した実施形態では、ステンレス鋼からなるノズルプレート 2 0 を例示したが、シリコンからなるノズルプレートであってもよい。なお、この場合には、ノズルプレートがインクに溶解されてしまうため、ノズルプレートの各圧力発生室内の少なくとも表面に保護膜を設けることが望ましい。

【 0 0 8 7 】

なお、上述の実施形態では、たわみ振動型のインクジェット式記録ヘッドについて説明したが、勿論これに限定されず、例えば、縦振動型のインクジェット式記録ヘッド、あるいは圧力発生室内に抵抗線を設けた電気熱変換式のインクジェット式記録ヘッド等、種々の構造のインクジェット式記録ヘッドに適用することができる。

【 0 0 8 8 】

さらに、上述の実施形態では、成膜及びリソグラフィプロセスを応用して製造される薄膜型のインクジェット式記録ヘッドを例にしたが、勿論これに限定されるものではなく、例えば、グリーンシートを貼付する等の方法により形成される厚膜型のインクジェット式記録ヘッドにも本発明を採用することができる。

【 0 0 8 9 】

また、このようなインクジェット式記録ヘッドは、インクカートリッジ等と連通するインク流路を具備する記録ヘッドユニットの一部を構成して、インクジェット式記録装置に搭載される。図 6 は、そのインクジェット式記録装置の一例を

示す概略図である。

【0090】

図6に示すように、インクジェット式記録ヘッドを有する記録ヘッドユニット1A及び1Bは、インク供給手段を構成するカートリッジ2A及び2Bが着脱可能に設けられ、この記録ヘッドユニット1A及び1Bを搭載したキャリッジ3は、装置本体4に取り付けられたキャリッジ軸5に軸方向移動自在に設けられている。この記録ヘッドユニット1A及び1Bは、例えば、それぞれブラックインク組成物及びカラーインク組成物を吐出するものとしている。

【0091】

そして、駆動モータ6の駆動力が図示しない複数の歯車およびタイミングベルト7を介してキャリッジ3に伝達されることで、記録ヘッドユニット1A及び1Bを搭載したキャリッジ3はキャリッジ軸5に沿って移動される。一方、装置本体4にはキャリッジ軸5に沿ってプラテン8が設けられており、図示しない給紙ローラなどにより給紙された紙等の記録媒体である記録シートSがプラテン8上に搬送されるようになっている。

【0092】

なお、上述した実施形態においては、本発明の液体噴射ヘッドの一例としてインクジェット式記録ヘッドを説明したが、液体噴射ヘッドの基本的構成は上述したものに限定されるものではない。本発明は、広く液体噴射ヘッドの全般を対象としたものであり、インク以外のアルカリ性の液体を噴射するものであればよく、例えば、プリンタ等の画像記録装置に用いられる各種の記録ヘッド、液晶ディスプレイ等のカラーフィルタの製造に用いられる色材噴射ヘッド、有機ELディスプレイ、FED（面発光ディスプレイ）等の電極形成に用いられる電極材料噴射ヘッド、バイオチップ製造に用いられる生体有機物噴射ヘッド等にも適用することができる。このように、アルカリ性の液体を噴射する液体噴射ヘッドに本発明を適用すれば、上述した実施形態と同じ優れた効果を得ることができる。

【0093】

【発明の効果】

以上説明したように本発明では、少なくとも圧力発生室の内壁表面に酸化タン

タルからなる耐液体性の保護膜を設けるようにしたので、流路形成基板が液体に溶解されるのを防止することができる。したがって、各圧力発生室の形状を製品製造時と略同一形状に維持することができ、液体吐出特性を長期間一定に維持することができる。

【0094】

また、各圧力発生室に対応して設けられた液体供給路や、連通部等の液体流路の内壁表面にも保護膜を設けることにより、液体流路の形状を製品製造時と略同一形状に維持することができる。したがって、各圧力発生室へ液体を良好に供給することができ、液体吐出特性をさらに長期間一定に維持することができるという効果も奏する。

【0095】

さらに、流路形成基板が液体に溶解されるのを保護膜によって防止することができるため、液体に溶解された流路形成基板の溶解物が液体中に析出する量が実質的に低減され、ノズル詰まりの発生を防止することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の実施形態1に係るインクジェット式記録ヘッドの分解斜視図である。

【図2】

本発明の実施形態1に係るインクジェット式記録ヘッドの平面図及び断面図である。

【図3】

本発明の実施形態1に係るインクジェット式記録ヘッドの製造工程を示す断面図である。

【図4】

本発明の実施形態1に係るインクジェット式記録ヘッドの製造工程を示す断面図である。

【図5】

本発明の実施形態1に係るインクジェット式記録ヘッドの製造工程を示す断面図である。

【図 6】

本発明の一実施形態に係るインクジェット式記録装置の概略図である。

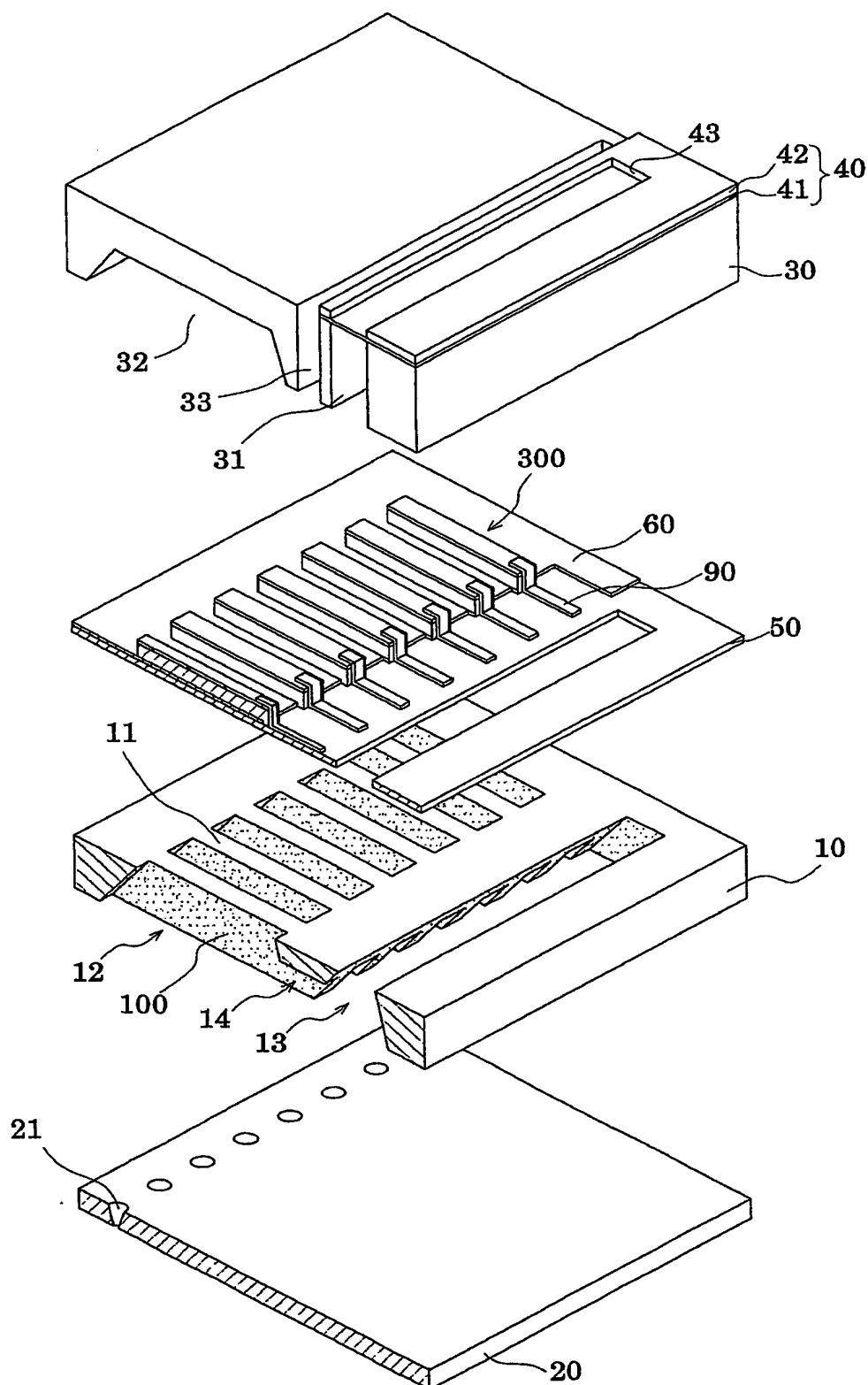
【符号の説明】

- 1 0 流路形成基板
- 1 2 圧力発生室
- 1 3 連通部
- 1 4 インク供給路
- 2 0 ノズルプレート
- 2 1 ノズル開口
- 3 0 封止基板
- 3 1 リザーバ部
- 3 2 圧電素子保持部
- 4 0 コンプライアンス基板
- 5 0 弾性膜
- 6 0 下電極膜
- 7 0 圧電体層
- 8 0 上電極膜
- 1 0 0 保護膜
- 1 1 0 リザーバ
- 3 0 0 圧電素子

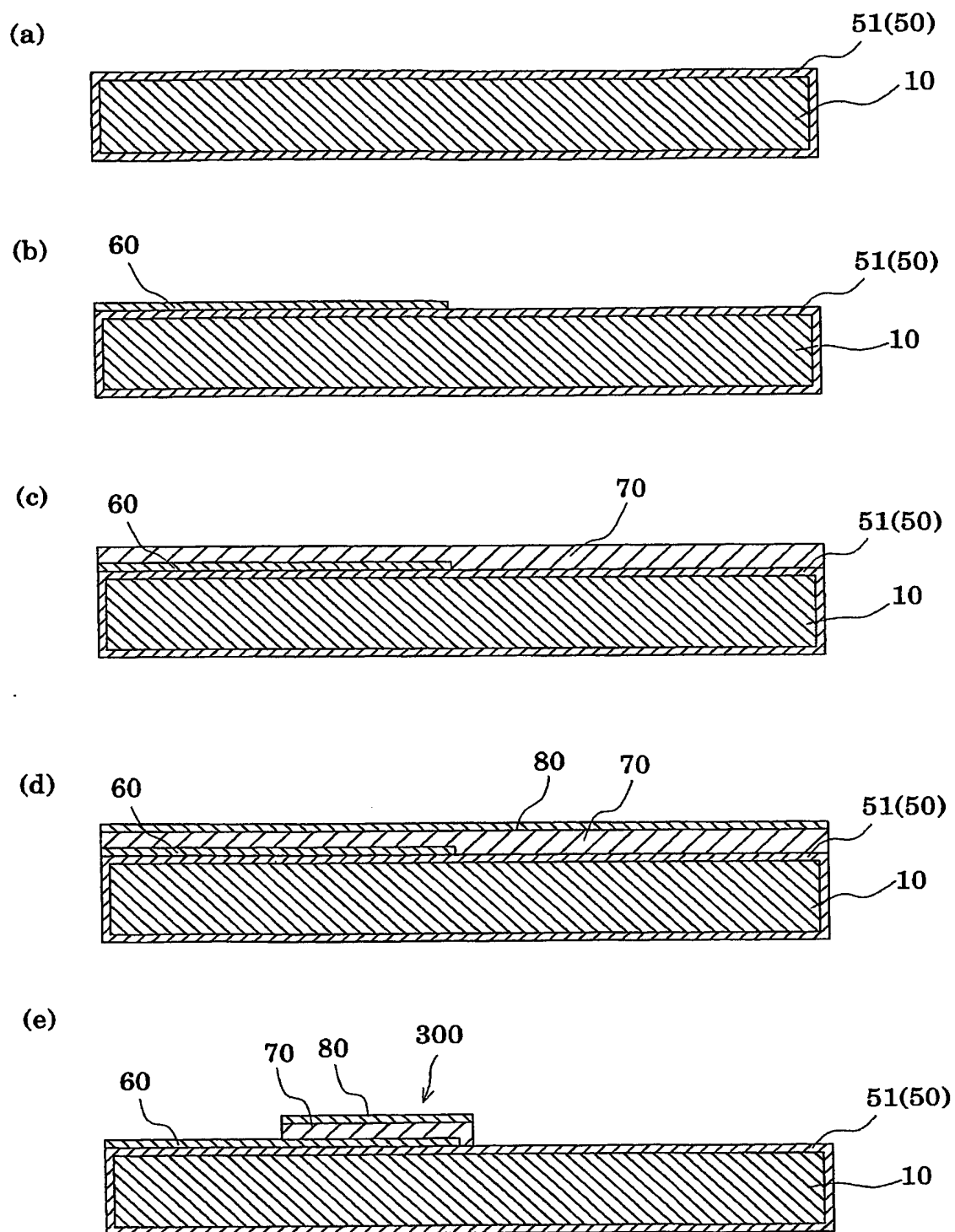
【書類名】

図面

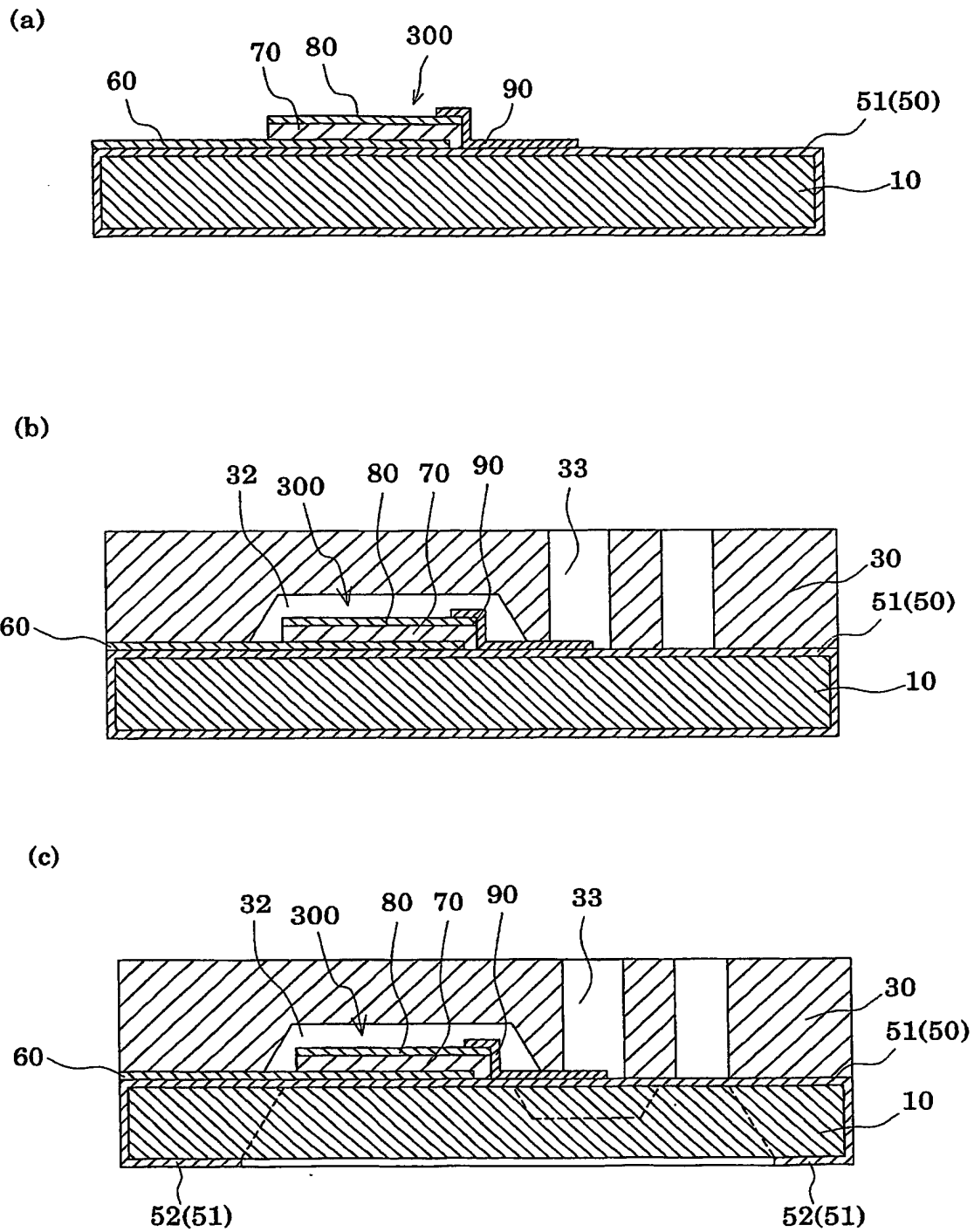
【図 1】



【図 3】

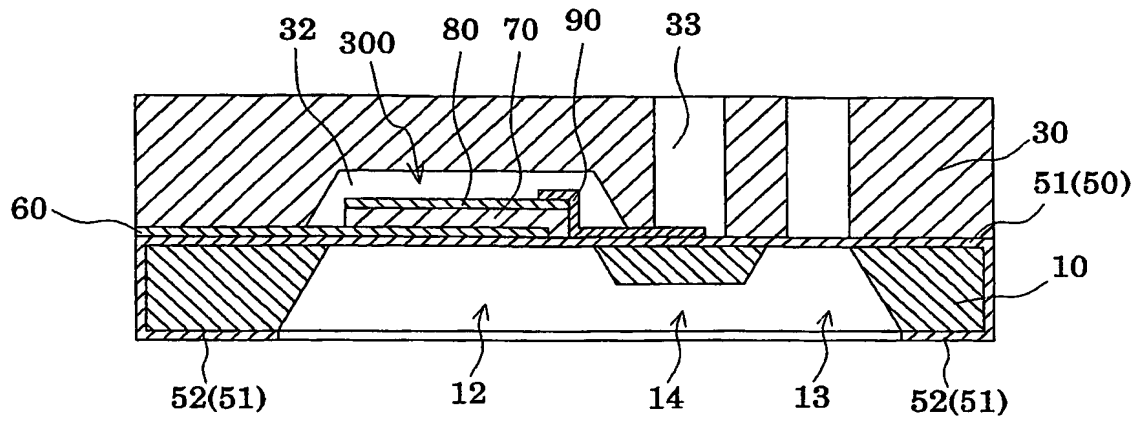


【図 4】

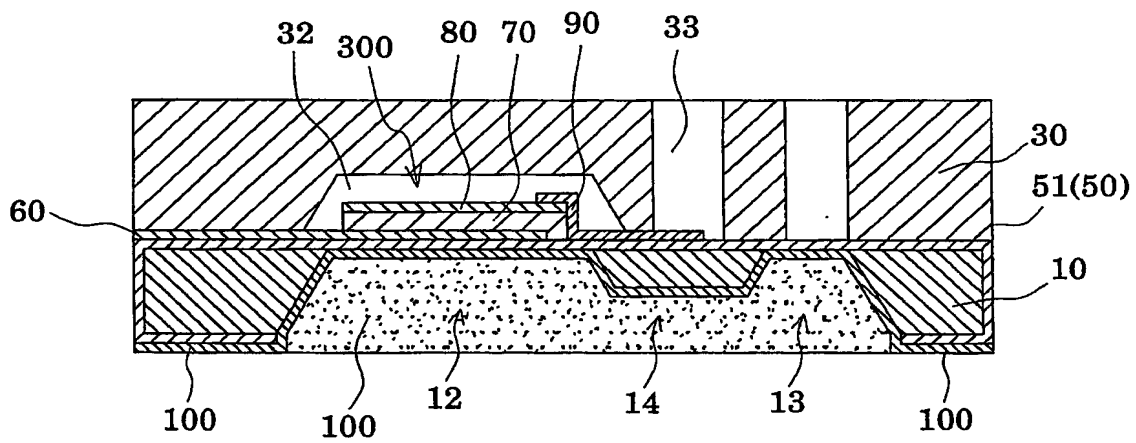


【図 5】

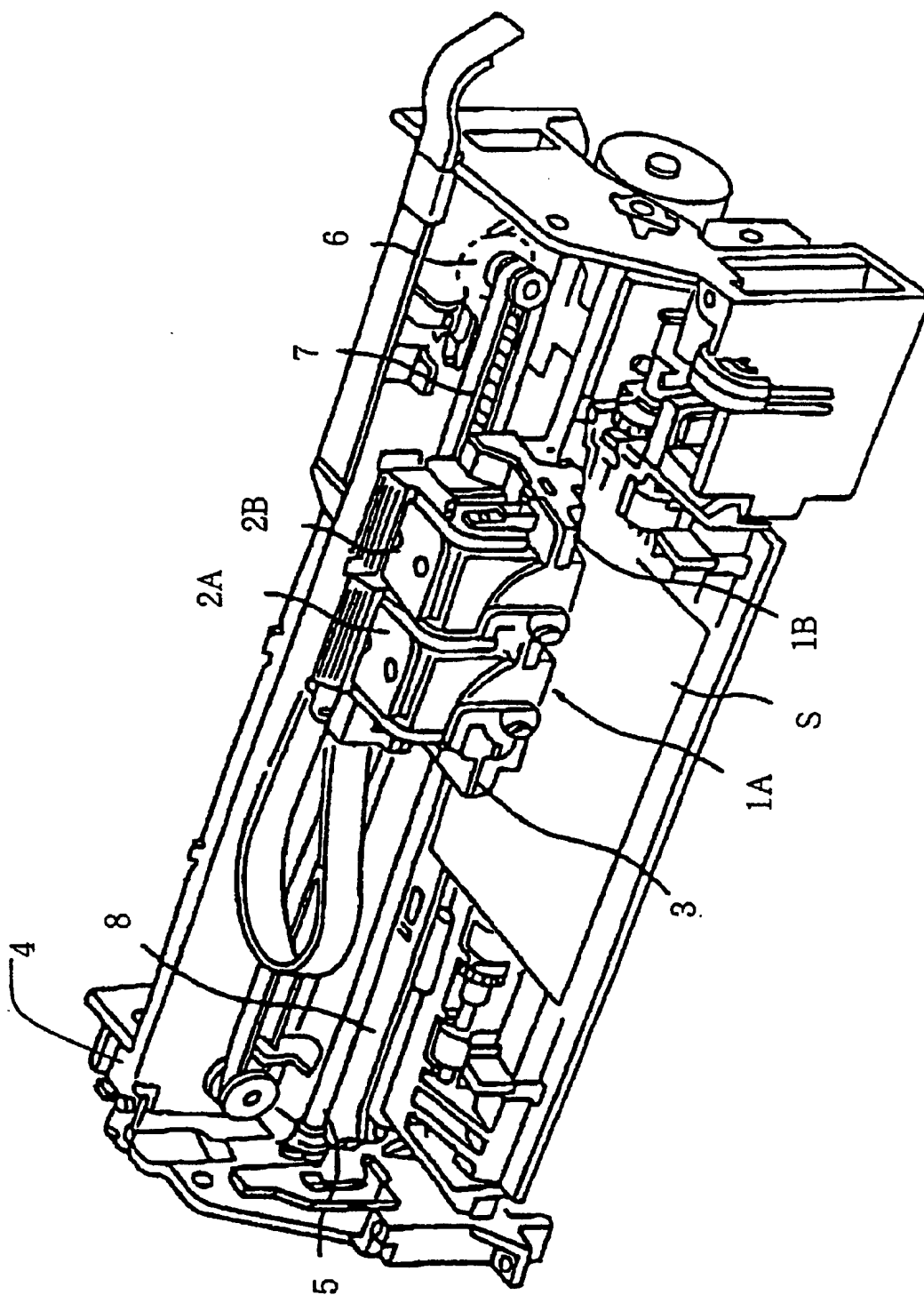
(a)



(b)



【図 6】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 液体吐出特性を長期間一定に維持することができ且つノズル詰まりを防止した液体噴射ヘッド及びその製造方法並びに液体噴射装置を提供する。

【解決手段】 シリコン単結晶基板からなりノズル開口21に連通する圧力発生室12が形成される流路形成基板10と、流路形成基板10の一方面側に振動板を介して設けられて圧力発生室12内に圧力変化を生じさせる圧電素子300とを具備する液体噴射ヘッドにおいて、少なくとも圧力発生室12の内壁表面に酸化タンタルからなる耐液体性の保護膜100を設けることにより、液体吐出特性を長期間一定に維持できると共にノズル詰まりを防止できる。

【選択図】 図1

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2002-227840
受付番号	50201160072
書類名	特許願
担当官	第二担当上席 0091
作成日	平成14年 8月 6日

<認定情報・付加情報>

【提出日】	平成14年 8月 5日
-------	-------------

次頁無

特願 2002-227840

出願人履歴情報

識別番号

[000002369]

1. 変更年月日

1990年 8月20日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

氏 名

セイコーエプソン株式会社